

脱・下請け構造

ソフトウェアとシステム統合で再定義する自動車部品業界の生存戦略

従来モデル

新時代

歴史的な岐路：ハードウェア中心の「系列」モデルが限界に

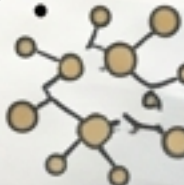
内燃機関（ICE）を前提としたハードウェアの「すり合わせ技術」を価値の源泉とし、OEMを頂点とする階層的な「系列」構造の中でQCD要求に応えることで成立してきたビジネスモデルは、CASE/SDV革命により根幹から揺らいでいる。

従来型モデル（ICE・系列構造）

-  価値の源泉：
ハードウェアの
「すり合わせ技術」
-  ビジネスモデル：
OEMからのQCD要求に
応える「受注生産」
-  サプライチェーン：
OEMを頂点とする
階層的・固定的な「系列」



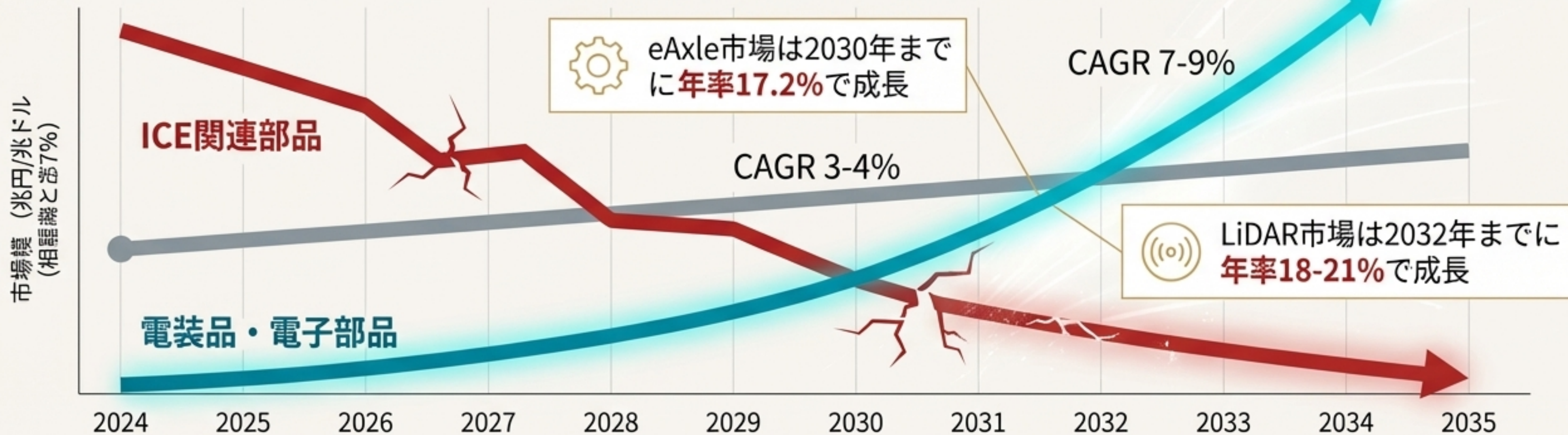
大変革の奔流（CASE・SDV）

-  電動化：
ICE関連事業の
「座礁資産化」 
-  ソフトウェア化：
クルマの価値が
ハードウェアから分離 
-  サプライチェーン：
伝統的な構造の
崩壊 

平均値の罠：市場全体の微成長の裏で起きる「価値の地殻変動」

世界の自動車部品市場全体は年3-4%で緩やかに成長するが、その内部ではICE関連部品の価値が急落し、CASE関連部品へ価値が爆発的に集中する二極化が進行している。現状維持は緩やかな衰退を意味する。

世界の自動車部品市場規模予測（2024-2035年）



この価値シフトのダイナミズムこそが、全ての戦略議論の出発点である。ICE関連に依存する企業は、市場全体が横ばいに見えても、実質的には急速な衰退に直面する。

二重の圧力：高度化要求と地政学リスクがサプライヤーを圧迫

サプライヤーは、OEMからの高度化・コスト要求と、地政学・規制の奔流という二つの巨大な圧力に挟まれ、利益構造が悪化している。



「コストを削減しながら、同時に技術レベルを飛躍的に向上させるという、この『二重の圧力』は、サプライヤーの経営を極めて困難なものにしている。」

業界の支配者が交代する：価値はサプライヤーから新たなプレイヤーへ

従来のOEMを頂点とする力関係は崩壊。半導体やバッテリー、ソフトウェアの巨人が業界の主導権を握り、サプライヤーは価値を奪われる側に回っている。



どの未来を選ぶか？ 生存に向けた3つの戦略的オプション

この構造変化に対し、企業を取りうる戦略は大きく3つに分けられる。どの道を選択するかで、未来は決定的に変わる。

パス A: 総合部品メーカー



概要: 全方位で製品ポートフォリオを維持・進化。

リスク: 莫大な経営資源が必要。巨人でなければ「器用貧乏」に陥る。

成功確率: **低い**

パス B: 特定分野のスペシャリスト



概要: 得意分野に資源を集中し、世界No.1を目指す。

リスク: 市場変化への耐性が低い。大手の下請けに甘んじる可能性。

成功確率: **中程度**

パス C: システムインテグレーター (Tier 0.5)



概要: 特定分野でHWとSWを統合したシステムソリューションを提供。

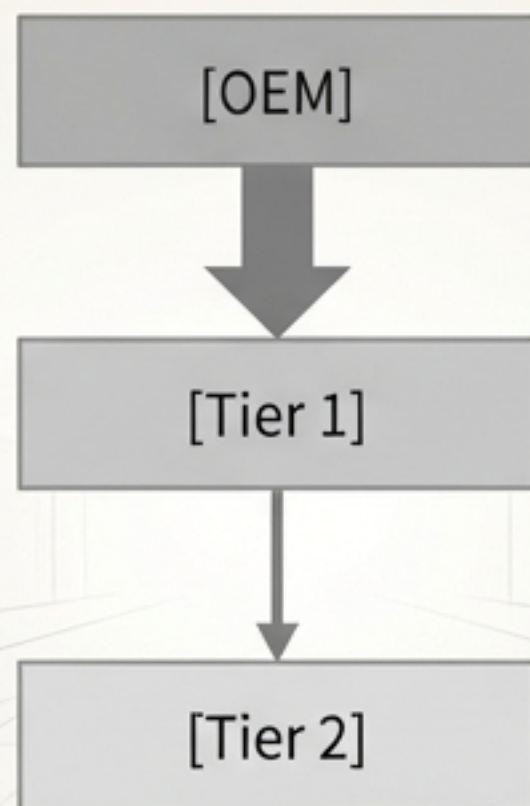
リターン: 最も付加価値の高いポジションを確保できる。

成功確率: **高い**

提言：単なる部品供給者から、OEMの戦略的パートナー「Tier 0.5」へ

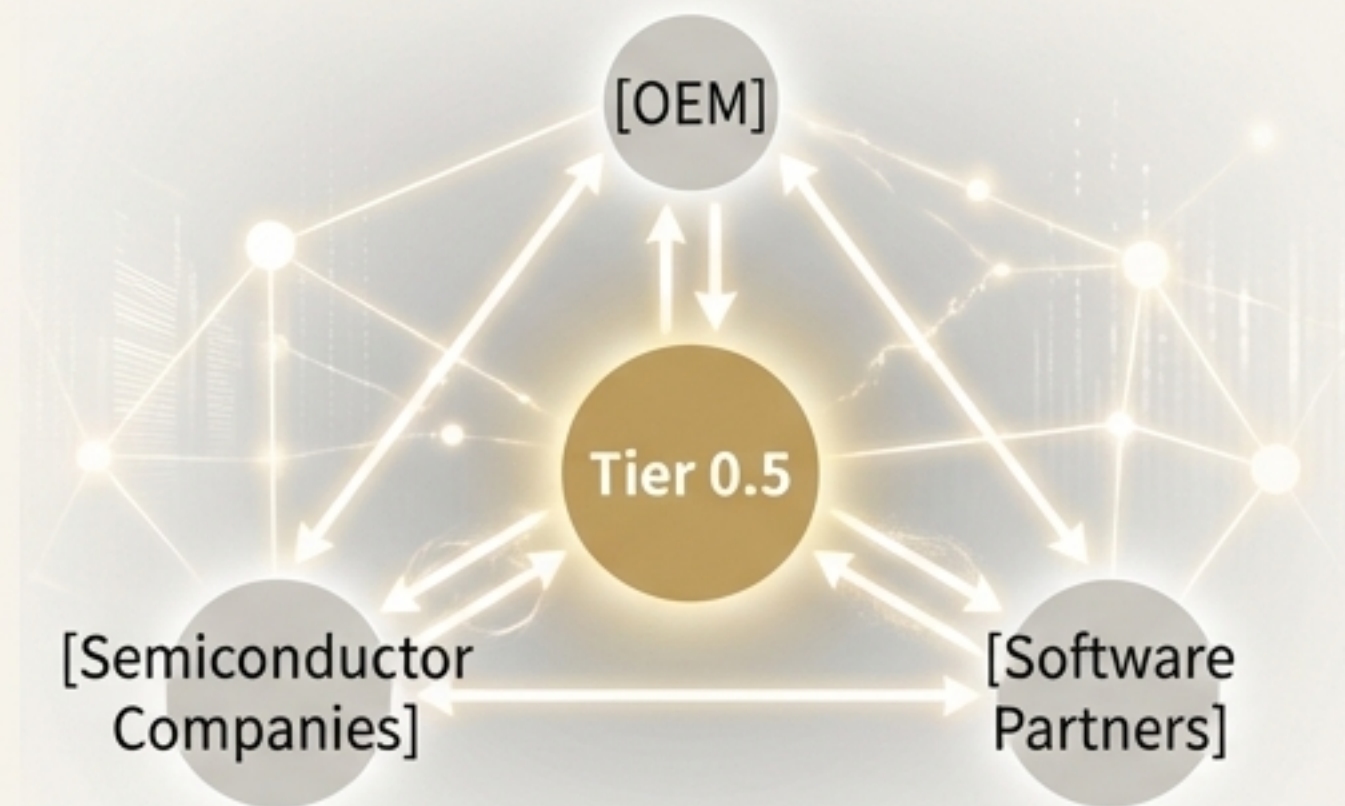
我々が提言する唯一の生存戦略は、特定の得意領域においてハードウェアとソフトウェアを垂直統合したシステムソリューションを開発し、OEMの企画・設計段階から深く関与する「Tier 0.5」への進化である。

Before: Tier 1（部品供給者）



- 役割: OEMの仕様に基づき部品を供給（受注生産）
- 力関係: OEMに従属
- 付加価値: ハードウェアのQCD

After: Tier 0.5（システムインテグレーター）



- 役割: システム全体のアーキテクチャを提案（提案型ビジネス）
- 力関係: OEMとの戦略的パートナーシップ
- 付加価値: ハードウェアとソフトウェアの統合ソリューション

変革を成し遂げるための4つの戦略的柱

「Tier 0.5」への進化は、事業ポートフォリオ、組織能力、企業文化、そして技術活用の全てを網羅する、全社的な変革によってのみ達成される。



決断： 事業の選択と集中

ICE関連事業を計画的に売却・カーブアウトし、創出した経営資源を成長領域へ集中再投資する。



進化： Tier 0.5への変革

得意領域でハードウェアとソフトウェアを垂直統合したシステムソリューションを構築し、提供価値を転換する。



獲得：ソフトウェア 人材への投資

GAFAMと競合する覚悟で報酬・文化を改革。「自前主義」を捨て、オープンなエコシステムを構築する。



革新：生成AIによる 破壊的創造

設計・開発・生産の全プロセスに生成AIを導入し、開発リードタイム半減と抜本的なコスト構造改革を実現する。

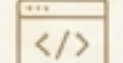
アクションプラン①：過去との決別と新たな価値創造

決断：事業ポートフォリオの抜本的再編

To Do

- 感傷的な判断を排した外科手術：縮小が避けられないICE関連事業（エンジン、トランスミッション等）のカーブアウト、事業売却を計画的に実行。
- 戦略的資本配分：創出したキャッシュ、人材、設備を、競合を凌駕するスピードで高成長領域へ再投資。

再投資領域の例

-  eAxle
-  パワー半導体（特にSiC）
-  統合ECU
-  センシング技術（LiDAR等）
-  車載ソフトウェア

進化：「Tier 0.5」への提供価値転換

To Do

- 得意領域の定義：自社のコア技術が活かせるドメイン（例：電動駆動システム、シャシー制御）を明確化。
- 垂直統合ソリューション開発：ハードウェアとソフトウェアを統合したシステムを開発し、OEMにアーキテクチャごと提案。
- 力関係の再定義：OEMとの関係を再定義し、付加価値の主導権を握る。

アクションプラン②：組織能力とプロセスの破壊的革新

獲得：ソフトウェア人材とオープンなエコシステム

To Do

- 熾烈な人材獲得競争への勝利：報酬体系、開発環境、企業文化をGAFAMを意識して抜本的に見直す。
 - 世界トップクラスのソフトウェアエンジニアを惹きつける組織を構築。
- 「自前主義」の完全放棄
 - 半導体メーカー、ソフトウェアプラットフォーマー、スタートアップとの戦略的アライアンスやM&Aを積極的に推進。
- オープンなエコシステムの中核を担う存在を目指す。

革新：生成AIによる開発・生産プロセス改革

To Do

- 構想で終わらせない全面的導入：設計、シミュレーション、検証、生産に至る全プロセスに生成AIやデジタルツインを導入。

具体的応用例

- ジェネレーティブデザイン：最適形状の自動生成による軽量化・高性能化。
 - ⚡ バーチャル走行試験：開発リードタイムを半減。
 - 🏭 スマートファクトリー：生産性の劇的向上とコスト構造改革。

変革実行に向けた3段階ロードマップ

この変革は、明確なマイルストーンとKPIを設定した3つのフェーズを通じて、計画的かつ迅速に実行する。



目標: 変革の土台を固める

Phase 1: 基盤構築
(Year 1-2)

- 戦略的ドメインの特定と事業計画策定
- ソフトウェア企業のM&Aまたは開発子会社設立
- ICE関連事業のカーブアウト計画策定

主要KPI



ソフトウェアエンジニア比率
(目標: 全エンジニアの50%)



目標: 具体的成果を創出し、
市場での評価を確立

Phase 2: システム開発と
パイロット導入 (Year 3-5)

- 次世代システム (HW+SW) のプロトタイプ完成
- 半導体メーカーとの戦略的提携締結
- 特定OEM (特に新興EVメーカー) との先行開発プロジェクト開始

主要KPI



特定OEMとの先行開発プロジェクト
契約数、ソフトウェアライセンス
収益の発生



目標: 業界のリーダーとしての地位を確立

Phase 3: グローバル展開と
エコシステム主導 (Year 6+)

- システムソリューションのグローバル
量産体制構築
- API/SDKを公開し、サードパーティ向け
エコシステムを構築
- データに基づく新サービス事業を開始

主要KPI



グローバル主要OEMへの採用数、
エコシステムパートナー数

競合は既に行動している：主要プレイヤーの戦略動向

グローバルメガサプライヤーから業界を破壊する新規参入者まで、全てのプレイヤーがSDV時代に適応すべく大胆な戦略転換を進めている。傍観している時間はない。

<u>プレイヤー区分</u>	<u>企業名</u>	<u>戦略の方向性</u>
メガサプライヤー	 Bosch	HWからSW、半導体まで網羅する包括的ソリューション。 SiC半導体への大規模投資。
	 Denso	「環境」「安心」を軸に、電動化とAD/ADAS領域へ資源を集中。 ソフトウェア開発力強化が急務。
日系大手	 Aisin	eAxleを最重要戦略製品と定め、2025年までに年産450万基の生産体制構築を目指す。
業界の破壊者	 NVIDIA	自動運転用AIコンピュータ「DRIVE Thor」を核に、 業界標準プラットフォームの地位を確立。
	 CATL	圧倒的な生産能力を武器に、バッテリー交換サービスなど エネルギーインフラ領域へ事業を拡大。

結論：勝者と敗者を分ける3つの決定的な能力

今後の業界の勝敗は、3つの能力をいかに迅速に獲得できるかに集約される。
我々の提言は、これらの能力を体系的に構築するための唯一の道筋である。

1



システム統合能力
(HW x SW)

個別の部品ではなく、ハードウェアとソフトウェアを統合した「システム」として価値を提供する能力。これがない企業は付加価値の低いレイヤーに追いやられる。

2



ソフトウェア開発における
スピードと品質の両立

アジャイル開発の「スピード」と、機能安全・サイバーセキュリティが求める「品質」を両立させる開発プロセスと組織文化。

3

変化に適応する
戦略的俊敏性
(Strategic Agility)

不採算事業から迅速に撤退する「決断力」と、成長領域へ大胆に再投資する「実行力」。

⬇ 最大の脅威

ICE関連事業の座礁資産化と、
異業種からのディスラプション

↗ 最大の機会

「Tier 0.5」としての新たなポジション確立と、
ソフトウェア・サービスによる収益化



現状維持は、緩やかな衰退を意味する。
大胆な変革こそが、唯一の生存戦略である。

Appendix: 主要データ

表1: 主要製品セグメント別 市場成長予測

製品セグメント	2024年 市場規模 (億ドル)	2035年 市場規模 (億ドル)	CAGR (2025-2035)
市場全体	約5,000	約7,500	約3-4%
エンジン・駆動系	約1,800	約2,100	約1-2%
内外装・シャシー	約1,600	約2,200	約3%
電装品・電子部品	約1,350	約3,000	約7-9%
eAxle	約650	約1,800 (2030年)	約17%
LiDAR	約30	約150 (2032年)	約18-21%
統合ECU	-	21兆円 (2035年)	高成長

*注: 各市場規模は複数のレポートから合成・概算した参考値。

表2: 主要メガサプライヤー 財務KPI比較 (2023年度)

企業名	売上高	調整後EBITマージン
Bosch	916億ユーロ	5.0%
Denso	7.1兆円	5.3%
Continental	414億ユーロ	6.1%
ZF	466億ユーロ	5.1%